



한국IR협의회

기업리서치센터 기업분석 | 2025.08.13



KOSDAQ | 반도체와반도체장비

**ISC** (095340)

**성장이 기대되는 테스트 소켓 전문기업**

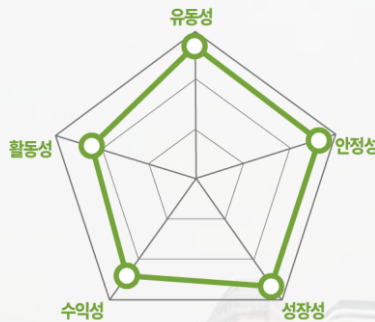
### 체크포인트

- ISC는 각종 반도체 IC Chip을 Test하기 위해 필요한 테스트 소켓(Test Socket)을 개발/생산하는 기업으로, 2023년 5월 SK그룹 산하 이차전자·반도체·친환경 소재 기업인 SKC(주)에 피인수
- 투자포인트는 1) AI 반도체 시장 성장 수혜 기대, 2) 자율주행, 로봇용 소켓 수주 본격화 기대, 3) 주주가치 친화적인 밸류업 공시는 긍정적
- 리스크 요인은 글로벌 경기의 하락 시 반도체 테스트 소켓 수요 감소 가능성

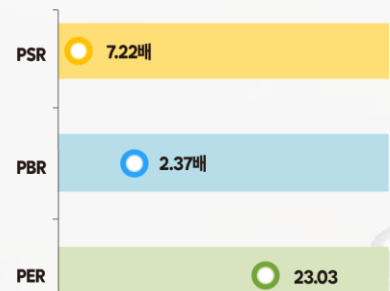
### 주가 및 주요이벤트



### 재무지표



### 밸류에이션 지표



## ISC는 SK그룹 계열의 반도체 테스트 소켓 제조기업

ISC는 2001년 설립된 반도체 검사장비 핵심 소모부품인 테스트 소켓 생산/판매 전문기업. 2024년 연간 기준 매출 형태별 비중은 테스트 소켓 95.2%, 장비소재 3.8%, 부동산 및 기타 1.0%

## 글로벌 반도체 테스트 소켓 시장 규모는 2031년 20.7억 달러 규모 기대

테스트 소켓은 반도체 검사 장비와 칩 사이를 연결해주는 소모성 부품으로, 테스트 소켓은 일반 테스트 소켓과 번인(Burn-in) 소켓 등으로 분류. 일반 테스트 소켓은 포고 타입과 러버 타입이 있음. 포고 타입 소켓은 칩 별 맞춤형 설계가 용이한 반면, 정밀 가공이 필요해 부품 원가는 높은 편. 러버 타입 소켓은 대량생산/납기 단축이 가능한 장점으로 인해 최근 시스템 반도체 분야에 활용. 글로벌 반도체 테스트 소켓 시장 규모는 연평균 7%로 성장하여 2031년 20.7억 달러 규모에 이를 전망. 테스트 소켓 산업은 반도체 생산량에 따른 소모성 수요뿐만 아니라, 고도화된 패키징 기술과 고객 맞춤형 설계 변화에 대응하는 R&D용 수요 등에 의해 견인됨

## 사상 최대 매출액이 기대되는 2025년

2025년 연결 기준 상반기 매출액, 영업이익 각각 834억 원(-1.8% YoY), 207억 원(-11.8% YoY) 기록. 이는 일부 제품믹스 악화와 고정비 증가, 일부 고객사 1분기 주문 부진에 기인. 2025년 연간 매출액, 영업이익 각각 2,093억 원(+20.0% YoY), 502억 원(+12.1% YoY)으로 전망. 하반기 주력 사업인 테스트 소켓 매출의 AI 반도체 수요 확대 수혜, 인수합병 통한 장비소재 매출액의 실적 기여가 예상되기 때문. 전반적인 매출 규모 확대 효과와 데이터센터, 스마트폰용 제품 믹스 개선으로 실적은 매출 중심으로 사상 최대 수준 달성 전망. 하반기 실적이 시장 눈높이를 충족하고, 인수한 아이세미, 테크드림이 연결 실적에 본격 기여한다면 주가는 최근 약세를 딛고 반등세 보일 전망

## Forecast earnings & Valuation

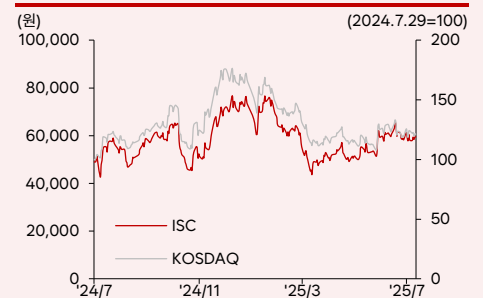
|              | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025F |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 매출액(억원)      | 1,447 | 1,789 | 1,402 | 1,745 | 2,093 |
| YoY(%)       | 18.8  | 23.6  | -21.6 | 24.4  | 20.0  |
| 영업이익(억원)     | 375   | 559   | 107   | 448   | 502   |
| OP 마진(%)     | 25.9  | 31.2  | 7.7   | 25.7  | 24.0  |
| 지배주주순이익(억원)  | 302   | 440   | 132   | 547   | 455   |
| EPS(원)       | 1,857 | 2,532 | 720   | 2,579 | 2,148 |
| YoY(%)       | 316.8 | 36.4  | -71.5 | 257.9 | -16.7 |
| PER(배)       | 19.0  | 12.4  | 111.5 | 28.0  | 28.0  |
| PSR(배)       | 4.0   | 3.0   | 10.5  | 8.8   | 6.1   |
| EV/EBITDA(배) | 11.5  | 6.9   | 73.3  | 22.0  | 15.3  |
| PBR(배)       | 2.6   | 2.0   | 3.6   | 2.9   | 2.3   |
| ROE(%)       | 15.3  | 17.9  | 3.6   | 11.0  | 8.5   |
| 배당수익률(%)     | 0.6   | 1.9   | 0.2   | 1.1   | 1.3   |

자료: 한국IR협회의 기업리서치센터

## Company Data

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 현재주가 (8/11)   | 60,100원           |
| 52주 최고가       | 76,800원           |
| 52주 최저가       | 43,600원           |
| KOSDAQ (8/11) | 811.85p           |
| 자본금           | 106억원             |
| 시가총액          | 12,739억원          |
| 액면가           | 500원              |
| 발행주식수         | 21'백만주            |
| 일평균 거래량 (60일) | 16만주              |
| 일평균 거래액 (60일) | 94억원              |
| 외국인지분율        | 17.09%            |
| 주요주주          | SKC 외 2인 48.89%   |
|               | Norges Bank 5.03% |

## Price & Relative Performance



## Stock Data

| 주가수익률(%) | 1개월 | 6개월   | 12개월 |
|----------|-----|-------|------|
| 절대주가     | -12 | -186  | 89   |
| 상대주가     | -25 | -24.8 | 2.5  |

▶참고 1) 표지 재무지표에서 안정성 지표는 '부채비율', 성장성 지표는 'EPS 증가율', 수익성 지표는 'ROE', 활동성지표는 '재고자산회전율', 유동성지표는 '유동비율'임. 2) 표지 밸류에이션 지표 차트는 해당 산업군내 동사의 상대적 밸류에이션 수준을 표시. 우측으로 갈수록 밸류에이션 매력도 높음.

▶기업 밸류업 공식 법인 주주가치 존중 기업문화로의 변화를 위해 자발적으로 기업가치 제고 노력을 하는 기업. 기업가치 제고 계획을 자율적으로 수립하고, 이행하며 투자자와 소통하는 기업

▶'글로벌 세그먼트'는 코스닥 시장 내 재무실적과 시장평가, 기업재배구조가 우수한 기업으로 한국거래소에서 선정한 기업



## 기업 개요

### ISC는 반도체 테스트 소켓 제조기업

**ISC는 2001년 설립되어 2007년  
상장한 테스트 소켓 제조기업**

ISC는 각종 전자부품 등에 사용되는 반도체 IC Chip을 Test하기 위해 필요한 테스트 소켓(Test Socket)을 개발 및 생산하는 기업이다.

ISC는 2001년 2월 반도체 및 전자부품 검사장비의 핵심 소모부품인 후공정의 테스트 소켓 제품 생산 등을 주 영업목적으로 설립되었으며, 2007년 10월 코스닥시장에 상장하였다. 2015년 산업통상자원부로부터 특허경영대상 기업부문 표창을 받기도 하였다. 2016년에는 제53회 무역의날 '삼천만불 수출의 탑'을 수상하였다. 2017년 산업통상자원부로부터 '2017 세계일류상품 및 생산기업'으로 선정되었다.

이후 2018년 KOTRA로부터 '월드챔프 300' 기업으로 선정되었고, 고용노동부로부터 '2018 대한민국 일자리 으뜸기업'으로 선정되기도 하였다. 또한, 2019년과 2020년 각각 중소벤처기업부로부터 '벤처 천억기업', '소부장 강소기업 100' 기업으로 선정되었다. 2021년에는 지멘스를 흡수합병하고 2022년에는 프로웰을 인수하였다.

2023년은 ISC에게 큰 변화의 해였다. ISC는 2023년 5월 SK그룹 산하 이차전지·반도체·친환경 소재 전문기업인 SKC(주)에 피인수되었다(1Q25말 기준 SKC(주)의 ISC 지분을 45.03%). 이로써 동사는 SK그룹 상호출자제한 기업집단에 편입되었다.

#### SK(주), SKC(주), ISC 지분도



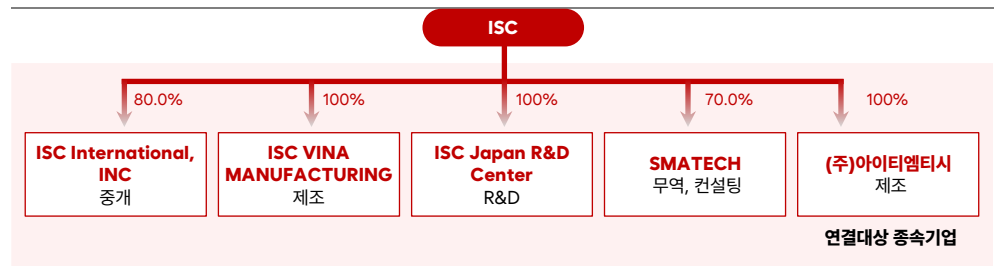
자료: Dart, 한국IR협의회 기업리서치센터

**1Q25말 기준 ISC의 연결대상  
종속회사는 총 5개사**

1Q25말 기준 ISC의 연결대상 종속회사는 총 5개사가 있다.

ISC International, INC는 2012년 설립된 미국 판매법인이고, ISC VINA MANUFACTURING은 2017년 설립된 베트남 생산법인이다. ISC Japan R&D Center는 2018년 설립된 연구소이고(현재는 휴업 중), SMATECH는 2013년 일본 도쿄에 설립되어 각종 판매 및 컨설팅 사업을 영위하고 있다. (주)아이티엠티시(ISC가 지분 100% 보유)의 경우 2021년 신규 설립되어 반도체 소켓(Socket)을 제조하고 있는데, 2025.02.24에 동사와 합병을 결의하고, 2025.03.13에 소규모 합병을 공고하였으며, 2025.04.30에 합병을 종료(합병기일)하였다.

## ISC 연결기준 종속회사 현황



주: 1) 1Q25말 기준 2) 2025.04.30 부로 (주)아이티엠티시는 소규모 합병으로 소멸  
자료: Dart, 한국IR협의회 기업리서치센터

**ISC는 아이세미-테크드림을  
인수하여 후공정 장비·소재  
라인업을 강화. 이들은 6월 연결  
재무제표에 반영되고 본격적인  
실적 기여는 3분기 이후 예상**

한편, ISC는 25.04.30에 SK엔펠스의 후공정 장비사인 '아이세미'와 PCB(인쇄회로기판) 제조사인 '테크드림'을 인수하였다. 아이세미와 테크드림의 2025년 합산 매출액은 500억 원, 영업이익은 50억 원 수준이 기대되며, 두 기업에 대한 인수 금액은 총 413억 원이었다. 인수를 통해 ISC는 AI가속기 테스트에 필수적인 모듈 테스터, 하이스피드 번인 테스터, HBM(고대역폭 메모리)용 소재를 포함한 고부가 장비 라인업을 확보하였다. 이를 통해 ISC는 중장기적으로 테스트 소켓 사업 중심에서 후공정 장비, 소재 기업으로 사업 영역을 다각화할 계획이다. 참고로 인수된 아이세미, 테크드림의 실적은 6월부터 ISC 연결 실적에 반영되고 있고, 본격적인 실적 기여는 3Q25이후일 것으로 예상된다.

## 아이세미, 테크드림 주요 사업 내용

| 제품           | 내용                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 모듈 테스터       | -DRAM 모듈의 CPU 호환성테스트 장비로 현재 글로벌 IDM과 팹리스 고객에 공급 중<br>-HBM, 글로벌 CPU, GPU 고객사향 실장 테스트 소켓 공동 개발 및 장비/소켓 턴키 공급 예정(25년 하반기)<br>-SOCAMM(System on a Module CAMM, 메모리&프로세서 통합 모듈), LPCAMM(Low Power CAMM, 저전력 모듈) 모듈 테스트 솔루션 개발 중 |
| 하이스피드 번인 테스터 | -NAND 패키징 번인 테스터로, 현재 국내 IDM 고객사에 장비 공급 시작<br>-복수의 글로벌 IDM에 퀄테스트 진행 중<br>-동사의 번인 소켓과 턴키로 공급 중                                                                                                                              |
| 세정 케미컬       | -식각 공정 후 발생된 이물질 제거를 위해 세정 시 사용하는 용액<br>-업계 유일 초순수를 사용하며, 현재 글로벌 HBM 고객사에 공급 중<br>-HBM 소재/부품 매출 증가 효과                                                                                                                      |

자료: ISC, 한국IR협의회 기업리서치센터

## 

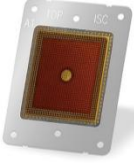
**2024년 기준 매출 비중은  
테스트 소켓 95.2%, 장비소재  
3.8%, 부동산 및 기타 1.0%**

2024년 연간 사업보고서 기준 매출 형태별 비중은 테스트 소켓 95.2%, 장비소재 3.8%, 부동산 및 기타 1.0%이다. ISC는 단기적으로는 여전히 테스트 소켓 사업 위주로 성장을 시현할 전망이다. 중장기적으로는 장비소재 사업 비중이 점진적으로 증가할 수 있을 것으로 예상된다. ISC 주요 제품들을 살펴보면 다음과 같다.

## 1) 메모리 테스트 소켓

ISC는 극소 Pitch에서 Normal Pitch(0.2P~1.0P)까지 모든 Memory Device/패키지 및 다양한 Test 환경에 맞는 Solution 및 관련 소켓을 제조/판매한다.

## 메모리 테스트 소켓

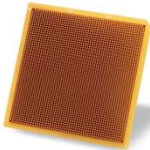
|                                                                                   |             |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 개요          | 극소 Pitch~일반 Pitch(0.2P~1.0P)까지<br>모든 메모리 디바이스 패키지(PKG) 테스트                                           |
|                                                                                   | 패키지 타입      | BGA, LGA, POP 등                                                                                      |
|                                                                                   | 지원 Pitch 범위 | 0.2P 이상                                                                                              |
|                                                                                   | 특징          | - 긴 수명<br>- 낮은 저항, 낮은 접촉력 (Multi-PARA)<br>- 고속, 저분진, 고전압 테스트 솔루션<br>- 볼 손상 없음<br>- 정전기 방전(ESD) 대응 가능 |

자료: ISC, 한국R협회의 기업리서치센터

## 2) 비메모리(로직) 테스트 소켓

ISC는 Long Test Time, Short Test Time, High Speed, 대면적 제품 등 Application(응용처)에 따른 Logic Device/패키지 Test에 최적화된 Solution 및 관련 소켓을 제공한다.

## 비메모리 테스트 소켓

|                                                                                     |             |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 개요          | 긴 테스트 시간, 짧은 테스트 시간, 고속, 대면적 등 애플리케이션에 따른<br>Logic 디바이스 패키지(PKG) 테스트                                                                        |
|                                                                                     | 패키지 타입      | BGA, LGA, QFN, QFP, CSP, SOP, TSOP 등                                                                                                        |
|                                                                                     | 지원 Pitch 범위 | 0.25P 이상                                                                                                                                    |
|                                                                                     | 특징          | - AP, CPU, GPU, PMIC, RF, 센서, 혼합 신호(Mixed signal) 테스트<br>- Validation, SLT, ATE<br>- 낮은 저항, 고속, 고전압 테스트 솔루션<br>- 볼 손상 없음<br>- 커스터마이징 테스트 가능 |

자료: ISC, 한국R협회의 기업리서치센터

## 3) 번인 소켓

번인 소켓은 Rubber를 응용한 Burn In Test Socket으로, Device No Ball Damage, PCB No Soldering, Hi Speed 구현 등 우수한 특성 및 구조를 가지고 있다. 고객 맞춤형의 Solution이다.

## 번인 소켓

|                                                                                     |          |                                                                                                |                                 |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | 항목       | DC BI 소켓                                                                                       | 일반 BI 소켓                        | 고속 BI 소켓 (High Speed BI)                                     |
|                                                                                     | 개요       | - Rubber를 응용한 Burn In Test Socket<br>- Device No Ball Damage, PCB No Soldering, Hi Speed 구현 가능 |                                 |                                                              |
|                                                                                     | 패키지 타입   | BGA, LGA 등                                                                                     | BGA, LGA, QFN 등                 | BGA 등                                                        |
|                                                                                     | 지원 Pitch | 0.3P~                                                                                          | 0.3P~                           | 0.8P~                                                        |
|                                                                                     | 특징       | - 테스트 조건에 따라 수명 상이<br>- 볼 손상 없음                                                                | - 테스트 조건에 따라 수명 상이<br>- 볼 손상 없음 | - 테스트 조건에 따라 수명 상이<br>- 볼 손상 없음<br>- 보드 수리 용이<br>- 고속 테스트 대응 |

자료: ISC, 한국R협회의 기업리서치센터

#### 4) 프루브 헤드(Probe Head)

ISC는 프루브 헤드를 통해 고성능 포고(POGO) Probe 및 초정밀 가공 Plate의 조합으로, 최적화된 Wafer Probing Solution을 제공한다. 동사의 MEMS(Micro-Electromechanical Systems, 나노머신) 공정을 적용한 고성능 MEMS Probe Head는 Low Force(낮은 접촉 압력), High CCC(High Current Carrying Capacity, 높은 전류 전달 용량), 고강도 Material 등의 우수한 특성으로 고객별로 맞춤 Solution 대응을 가능하게 해준다.

프루브 헤드

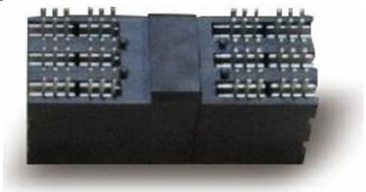
| 항목       | POGO Probe Head                                                                                                        | MEMS Probe Head                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 개요       | POGO 프로브와 초정밀 가공 플레이트 조합으로 최적화된 웨이퍼 프로빙 솔루션을 제공                                                                        | MEMS 공정을 적용한 고성능 Probe Head는 낮은 접촉력(Low Force), 높은 전류 용량(High CCC), 고강도 소재(Material)의 우수한 Contact 특성                     |
| 패키지 타입   | Wafer (WLCSP)                                                                                                          | Wafer (SOC)                                                                                                              |
| 지원 Pitch | 120 $\mu\text{m}$ ~                                                                                                    | 80 $\mu\text{m}$ ~                                                                                                       |
| 특징       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- RF 타입, 신호 길이 2.0mm</li> <li>- 솔더 범프</li> <li>- 웨이퍼 프로빙 및 단일 다이 테스트</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고 CCC &gt; 1A</li> <li>- 구리 필러 (평면 타입)</li> <li>- 와이어 본드 패드 (포인트 타입)</li> </ul> |

자료: ISC, 한국IR협회의 기업리서치센터

#### 5) 커넥터

커넥터(Connector)는 전류를 잘 통하게 하고, 장/탈착 조작을 간단하게 할 수 있도록 한 전자부품으로, 회로의 연결기능을 하는 Contact, Socket(Female), Pin Header(Male)로 구성되어 있다.

커넥터

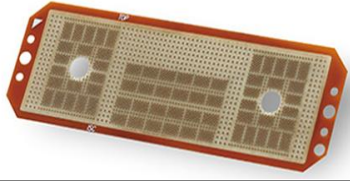
|                                                                                     |    |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 개요 | Connector는 2개소 사이에 전류를 통하게 하고, 장/탈착 조작을 간단하게 할 수 있도록 한 전자부품으로, 회로 연결 기능을 하는 Contact, Socket(Female), Pin Header(Male)로 구성 |
|                                                                                     | 특징 | 배선의 단순화                                                                                                                   |

자료: ISC, 한국IR협회의 기업리서치센터

#### 6) 카메라모듈 소켓, 인터포저(Interposer) 등

ISC의 카메라모듈 소켓은 고객의 니즈에 부합하는 다양한 형태로 제작 가능하다. 또한 테스트 소켓 시장에서의 오랜 경험을 토대로 내구성을 보장하며 기존과 다른 신개념 구동 방식을 보유하고 있다. 한편, ISC 인터포저(Interposer)는 높은 안정성을 갖추고 있고 고객 요구사항에 따라 Special Rubber Solution 적용도 가능한 주문 제작형 제품이다.

## 카메라모듈 소켓, 인터포저(Interposer)

|          | 카메라모듈 소켓                                                                          | 인터포저                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |  |               |
| 제품       | CCM Auto Socket                                                                   | MEMS Probe Head                                                                                  |
| 패키지 타입   | Bottom Move                                                                       | Top Move                                                                                         |
| 지원 Pitch | 0.3, 0.35mm~                                                                      | 0.3, 0.35mm~                                                                                     |
| 특징       | - 비자성 (Non-Magnetic)                                                              | - 비자성 (Non-Magnetic)                                                                             |
|          |                                                                                   | Interposer<br>Board to Board, Probe card 등<br>- 높은 접촉 안정성<br>- 보드 손상 없음<br>- 힘 없음<br>- 저접촉력, 저저항 |

자료: ISC, 한국IR협회의 기업리서치센터

## 3 주고객은 글로벌 비메모리 반도체 기업들

주요 고객은 글로벌 비메모리  
파운드리 및 팹리스, OSAT.  
1H25 기준 소켓 매출 중  
비메모리 비중 85.6%

ISC의 주요 고객은 글로벌 비메모리 반도체 기업들이다. 2025년 상반기 기준으로 동사의 테스트 소켓은 메모리향 보다는 비메모리향이 많은 상황이므로(1H25 기준 소켓 매출 중 비메모리 비중 85.6%), 주요 고객은 글로벌 비메모리 파운드리 및 팹리스, OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly And Test, 반도체 후공정) 기업들이다. 주 고객들이 언론 보도 등에 민감하여 구체적으로 고객 사명을 밝히기는 어렵다고 보이나, 데이터센터, 스마트폰, PC, 차량 반도체용 비메모리 반도체를 제조/판매하는 글로벌 비메모리 반도체 기업들이 동사의 핵심 고객인 상황이다. 또한 올해 6월부터 편입되는 연결 자회사인 아이세미와 테크드림으로 인하여 종합반도체 고객군의 확대도 향후 예상된다.

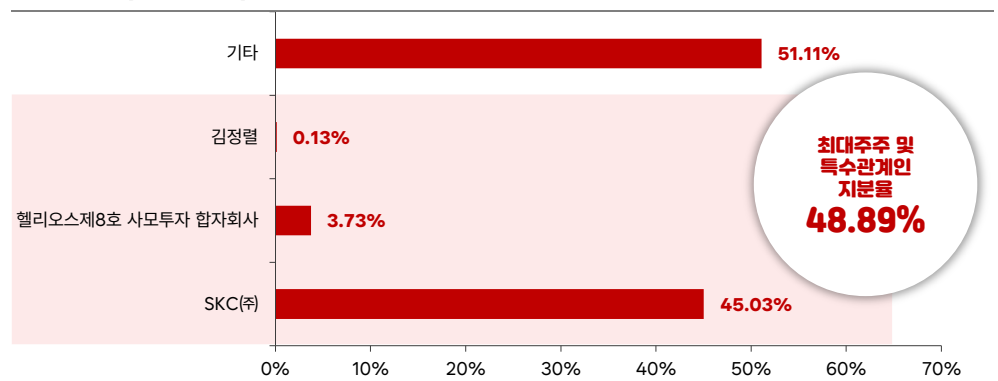
## 4 최대주주 등은 SKC(주) 외 2인

ISC 최대주주 등은 SKC(주) 외  
2인으로, 지분율 48.89%를 보유

ISC 최대주주 등은 SKC(주) 외 2인으로, 지분율 48.89%를 보유 중이다(1Q25말 기준).

동사 최대주주인 SKC(주)는 SK그룹 산하 이차전자반도체-친환경 소재 전문기업이다. SKC(주)는 1973년 설립되어 1997년 코스피에 상장되었다. 참고로 SKC(주)의 모회사는 SK(주)로, SK(주)는 SKC(주) 지분 40.6%를 보유하고 있다. SK(주)는 연결실체 내 종속기업수 총 649개사를 보유 중인 지주사이다.

## ISC 주주 현황(1Q25말 기준)



자료: Dart, 한국IR협회의 기업리서치센터



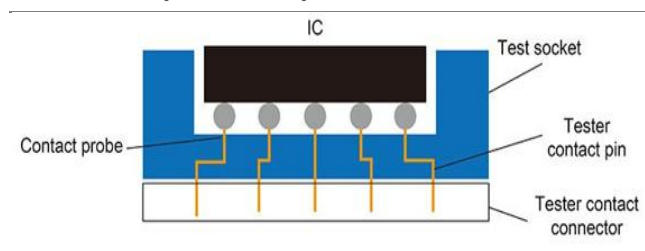
## 산업 현황

## 1 글로벌 반도체 테스트 소켓 산업 현황

**반도체 테스트 소켓은 검사 장비와  
칩 사이를 연결해주는 소모성 부품**

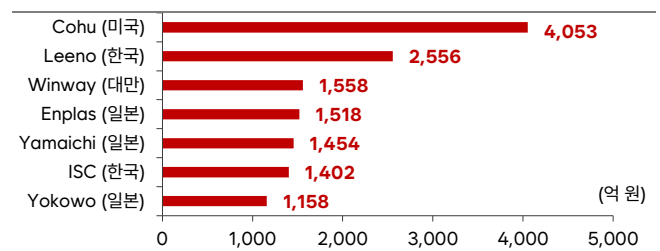
반도체 테스트 소켓(Test Socket)은 최종 패키징 공정을 마친 반도체 칩의 기능 검증과 불량 여부를 판단하는 테스트 공정에서 검사 장비와 칩 사이를 연결해주는 소모성 부품으로, 일반 테스트 소켓과 번인(Burn-in) 소켓 등으로 분류된다. 일반 테스트 소켓은 신제품 설계 검증, 전기적 특성 평가 등 반도체 개발/양산 전후의 다양한 공정에서 반복적으로 사용되고, 번인 소켓은 고온·고전압 환경에서 칩을 장시간 동작시켜 초기 발생할 수 있는 잠재 불량을 검출하는 데 활용된다. 시장조사기관 Global Growth Research에 따르면 전체 반도체 테스트 소켓 시장 내 일반 테스트 소켓의 점유율은 60%, 번인 소켓 외 기타가 40%이다. 2023년 기준 글로벌 상위 7개사의 반도체 테스트 소켓 매출액 합계는 약 1.4조 원이며, 반도체 테스트 소켓 시장은 Cohu(미국), 리노공업, Yamaichi(일본) 등 상위 5개 업체가 전체 시장 내 60~65% 이상 점유율을 차지하고 있다. 반도체 테스트 소켓은 반도체 품질(신뢰성/안정성 등)과 직결되기 때문에 기존 공급 레퍼런스가 중시되고, 초기 투자 비용 부담으로 인해 진입 장벽이 높은 것이 특징이다.

반도체 테스트 소켓(IC Test Socket) 구조



자료: Hioki, 한국IR협회의 기업리서치센터

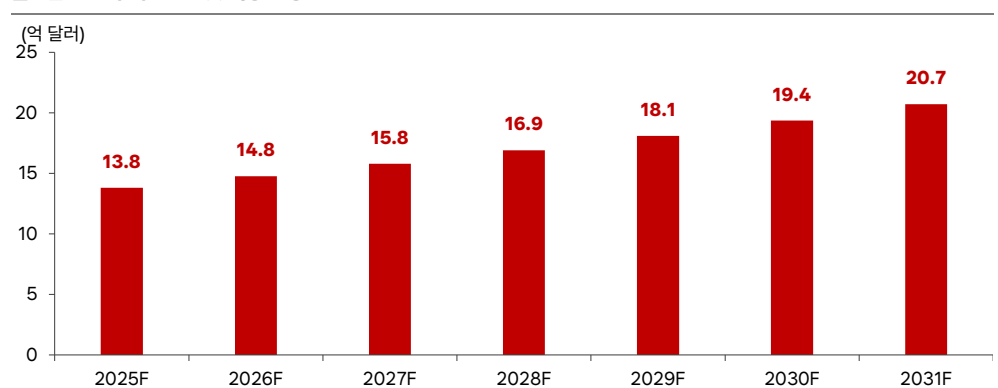
글로벌 반도체 테스트 소켓 업체별 매출액 순위



**글로벌 반도체 테스트 소켓 시장  
규모는 연평균 7%로 성장하여  
2031년 20.7억 달러에 이를 전망**

AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 적용 확대에 따른 커스텀 반도체(ASIC) 수요가 증가하고, 이에 따라 테스트 소켓의 적용 범위가 넓어지며 테스트 소켓 전방 수요가 확대되고 있다. 시장조사기관 Verified Market Reports에 따르면 글로벌 반도체 테스트 소켓 시장 규모는 빅테크 기업들의 ASIC 개발 가속화 등에 따라 2025년 13.8억 달러에서 연평균 7%로 성장하여 2031년에는 20.7억 달러 규모에 이를 전망이다.

글로벌 반도체 테스트 소켓 시장 전망



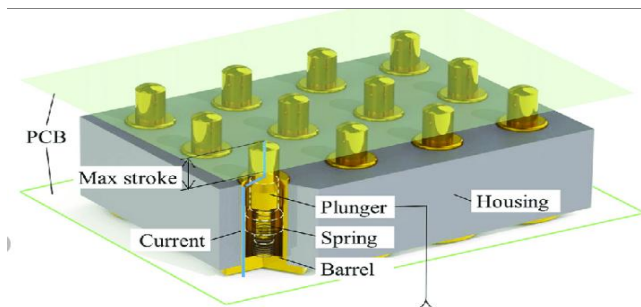
**일반 테스트 소켓은****포고 타입과 러버 타입으로 분류**

일반 테스트 소켓은 구조에 따라 크게 포고 타입 소켓과 실리콘 러버 타입 소켓으로 분류된다. 국내 기업 중에서는 대표적으로 리노 공업이 포고 타입 소켓에, ISC가 러버 타입 소켓에 강점을 보유하고 있다.

**포고 타입 소켓은 포고 핀 형태를****모듈화한 것으로, 칩 별 맞춤형****설계가 용이한 반면, 정밀 가공이****필요해 부품 원가는 높은 편**

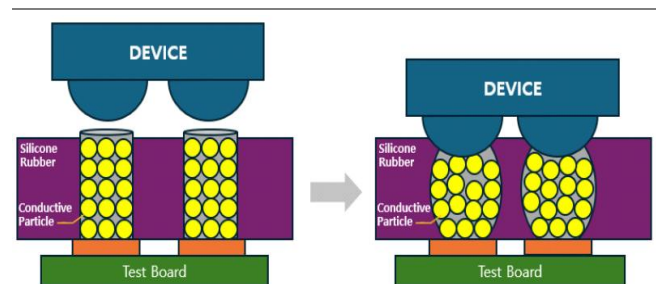
포고 타입 소켓은 일반 테스트 소켓 시장의 약 60~80% 비중을 차지하는 것으로 추정된다. 포고 타입 소켓은 간단히 말해 '포고 핀의 집합'이라고 할 수 있다. 포고 핀의 동작 구조를 아래 그림과 같이 살펴보면, 플런저가 칩의 단자에 압력을 가해 전기 접촉을 형성하고, 내부의 스프링이 일정한 힘을 유지함으로써 접촉 안정성을 확보한다. 이때 스프링과 플런저를 감싸는 금속 배럴은 핀의 형상을 유지하고 전류 흐름을 안정적으로 유도하는 역할을 한다. 참고로 스프링의 길이 증가에 따라 신호의 전기적 경로가 길어질 경우 고주파 테스트 신뢰성이 저하되므로, 핀과 스프링을 짧게 설계하는 것이 중요하다. 포고 소켓은 포고 핀을 모듈화한 구조이기 때문에, 다양한 반도체 패키지 형태에 맞춰 맞춤형 설계가 가능하며, 이러한 설계 유연성 덕분에 주로 비메모리 반도체 테스트에 활용된다. 반면에 포고 핀은 그 구조상 제조 시 정밀 가공이 필요하고 부품 원가가 상대적으로 높다는 단점이 있다.

포고 타입 핀/소켓 주요 기업으로는 리노공업, Yokowo(일본), Winway(대만), ISC, 티에스이 등이 있으며, 포고 타입 소켓 시장 규모는 2025년 약 56억 달러에서 2033년까지 12.9억 달러까지 연평균 12.8% 성장할 것으로 예상된다.

**포고 타입 소켓 동작 구조**

주: 포고 핀은 크게 플런저, 스프링, 배럴 3가지 부품으로 구성

자료: ResearchGate, 한국IR협회의 기업리서치센터

**러버 타입 소켓 동작 구조**

자료: 한국과학기술학회 2024 추계 학술발표논문, 한국IR협회의 기업리서치센터

**러버 타입 소켓은 고속 테스트가****필요한 메모리 반도체에 주로****사용되어 왔으나, 대량생산/납기****단축이 가능한 장점으로 인해 최근****시스템 반도체 개발에도 활용**

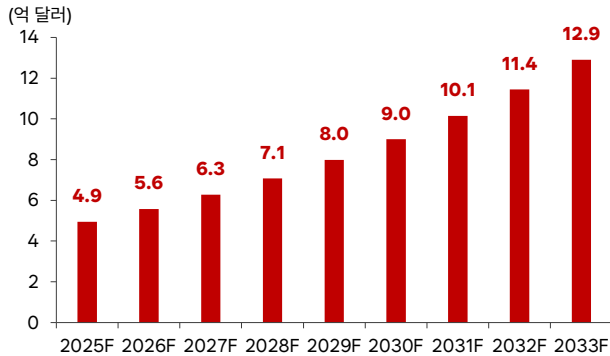
러버 타입 소켓은 금속 핀 대신 도전성 실리콘 러버 매트릭스를 이용해 테스트 칩과 테스트 보드 사이의 전기적 연결을 형성하는 구조이다. 테스트 보드 위에 반도체 패키지를 올리고 압력을 가하면 러버 내부에 분산된 미세 금속입자나 도전성 섬유가 압축되면서 전기 통로가 형성된다(위 오른쪽 그림 참조). 이 과정에서 금속 분말과 반도체 패키지 간 전기적 접점이 생성되고, 이를 통해 전기 신호가 테스트 보드로 전달된다. 러버 소켓의 가장 큰 장점은 구조의 단순성과 얇은 두께, 그리고 핀 간 간격이 매우 좁은 패키지에도 적용 가능하다는 점이다. 별도의 금속 스프링이 없고 접촉 면이 넓으며 삽입력이 낮기 때문에, 테스트 중 패키지 단자의 손상을 최소화할 수 있다. 또한, 스프링이 없는 구조로 신호 경로가 짧아지면서 저항력과 정전용량이 감소하고, 이로 인해 고주파 대역에서도 안정적으로 동작한다. 이러한 특성 덕분에 실리콘 러버 소켓은 전통적으로는 고속 테스트가 필요한 메모리 반도체 분야에서 주로 사용되어 왔다.

최근에는 비메모리 반도체 개발 단계에서도 러버 소켓 도입 사례가 증가하고 있는데, 이는 구조가 단순한 만큼 금형 기반으로 대량 생산이 가능하고, 전반적인 납기 단축과 원가 절감에 유리하기 때문이다. 실제로 러버 소켓 시장 점유율 1위 업체인 ISC의 경우, 비메모리 반도체용 매출 비중은 최근 3개년(2022~2024) 동안 61% → 79% → 85%로 꾸준히 증가하고 있다. 또한 러버 타입 소켓은 접촉 면이 넓어, 패키지 면적이 커질수록 발생하는 굴곡(Warping) 현상에 효과적으로 대응할 수 있다는 장점도 있다. 다만, 러버 소재는 반복된 압축이나 고온 환경에서 빠르게 열화되며, 이에

따라 포고 타입 대비 내구성이 약하고 전류 용량이 낮다. 이러한 한계로 인해 BGA(Ball Grid Array), LGA(Land Grid Array) 등 특정 패키지 테스트에 주로 적용된다. 수명이 짧다는 단점도 있다.

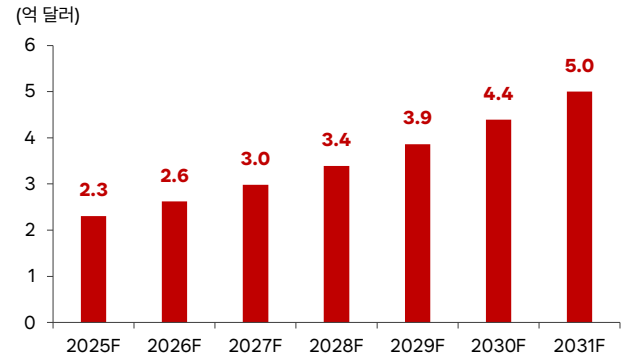
러버 타입 소켓 시장 내 주요 기업으로는 ISC, 티에스이, WinWay(대만) 등이 있다. QYResearch에 따르면 러버 타입 소켓의 시장 규모는 2025년부터 연평균 13.8%로 성장하여 2031년 5.0억 달러 규모에 달할 전망이다.

글로벌 포고 타입 소켓 시장 전망



자료: Business Research Insights, 한국IR협회의 기업리서치센터

글로벌 러버 타입 소켓 시장 전망



자료: QYResearch, 한국IR협회의 기업리서치센터

#### 번인 소켓은 반도체 초기 불량 여부를 극한의 환경에서 검증하기 위해 사용되는 소모성 부품으로, 번인 보드에 실장되어 사용

번인 소켓(Burn-in Socket)은 반도체 칩의 성능과 초기 불량 여부를 극한 환경에서 검증하기 위하여 사용되는 소모성 부품이다. 일반적인 포고 또는 러버 타입 소켓이 실온에서 기능 검사를 수행하는데 비해, 번인 소켓은 고온·고전압 조건에서 칩의 신뢰성을 평가하는 데 사용된다. 번인(Burn-in) 테스트는 제품에 125~180℃의 고온과 높은 전압을 수 시간 동안 인가하여 잠재적인 불량품을 사전에 제거하는 과정으로, 최종 제품의 수율과 신뢰도를 향상시키는 데 그 목적이 있다. 번인 소켓은 이러한 스트레스 환경에서 반복적으로 사용되기 때문에 고온에서도 특성 변화가 적고 높은 내열성과 내구성을 갖춘 소재가 사용되며, 번인 보드(Burn-in Board, BIB)에 실장되어 사용된다. 번인 소켓 사업을 영위하는 주요 기업은 Cohu(미국), 마이크로컨텍솔, 오킨스전자, ISC 등이 있다.

반도체 테스트 소켓 주요 특징 비교

| 분류      | 포고(Pogo) 타입 소켓                                                    | 러버(Rubber) 타입 소켓                                                             | 번인(Burn-in) 소켓                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 소재 및 구조 | - 스프링, 플런저, 베럴로 구성된 포고 핀<br>- 핀을 모듈화한 구조                          | - 도전성 실리콘, 고무 등 탄성체<br>- 내부 금속 분말과 반도체 패키지 간 전도성 형성                          | - 고온/고전압 내성 재질<br>- 번인 보드(BIB)에 실장              |
| 특징      | - 접촉 안정성 높음<br>- 다품종 소량생산에 유리<br>- 맞춤형 설계 용이<br>- 정밀 가공 필요, 단가 높음 | - 접촉 면 넓고 삽입력 낮음<br>- 핀 간 간격 좁은 패키지 대응 가능<br>- 고속 테스트에 적합<br>- 반복 압축 시 열화 쉬움 | - 고온·고전압 환경에서 초기 불량 제거<br>- 반복 사용 가능, 높은 내열성 필요 |
| 적용 분야   | - 시스템 반도체 중심                                                      | - 메모리 반도체 중심<br>- 최근 비메모리 개발에도 활용                                            | - 초기 불량 제거 목적의 신뢰성 테스트                          |
| 주요 기업   | 리노공업, Yokowo, ISC, 티에스이 등                                         | ISC, 티에스이, Winway(대만) 등                                                      | Cohu, 마이크로컨텍솔, 오킨스전자 등                          |

자료: ISC, 리노공업, 연륜종합, 한국IR협회의 기업리서치센터

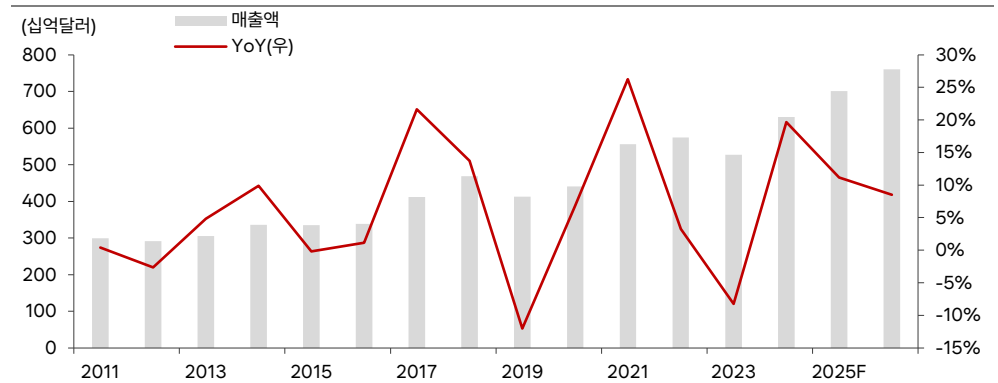
## 글로벌 반도체 시장 전망 및 테스트 소켓 시장 트렌드

**2025년 글로벌 반도체 시장  
규모는 전년 대비 11.2% 성장한  
6,972억 달러 규모로 전망**

반도체 테스트 소켓의 전방 시장인 글로벌 반도체 시장은 2023년 5,269억 달러에서 2024년 6,269억 달러(+19.0% YoY)로, 2025년 6,972억 달러(+11.2% YoY) 규모로 성장할 전망이다.

2024년 반도체 시장은 메모리(+81.0% YoY)가 주도하고, 비메모리는 전년 대비 5.8% 성장한 것으로 추정된다. 비메모리 시장 내 특이점은 Logic 시장이 전년 대비 16.9% 성장하였다는 것이었다. 2025년에는 메모리와 Logic 시장이 각각 전년 대비 13.4%, 16.8% 성장하며 전체 반도체 시장 성장(+11.2% YoY)을 견인할 것으로 예상된다.

### 글로벌 반도체 시장 규모 및 전망



자료: WSTS, 한국IR협회의 기업리서치센터

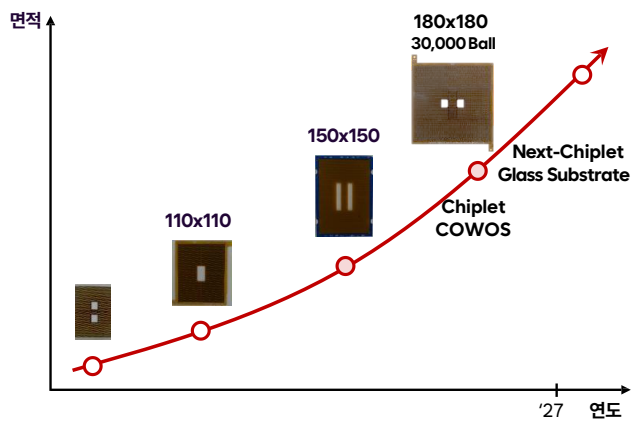
**테스트 소켓 산업은 반도체  
생산량에 따른 소모성 수요 뿐  
아니라, 고도화된 패키징 기술과  
고객 맞춤형 설계 변화에 대응하는  
R&D용 수요에 의해 견인됨**

일반적으로 테스트 소켓은 소모성 부품으로, 반도체 업체들의 생산량 및 가동률과 일정 부분 연동된다. 그러나 소켓 수요는 단순히 반도체 시장의 성장률과 동일한 흐름을 따르지 않는 데, 이는 테스트 소켓에 대한 커스터마이징 수요가 증가하고 있기 때문이다. 시스템(비메모리) 반도체와 메모리 반도체 모두에서 고성능화를 위한 패키징 기술 진화가 빠르게 전개되면서, 테스트 소켓의 수요 역시 정형화된 흐름이 아닌 다변화된 방향으로 증가하고 있다. 반도체 업체가 신 공정으로 제조를 이행하거나 칩 설계를 일부만 변경하더라도, 이에 대응하는 새로운 테스트 소켓이 필요하다. 이처럼 R&D용 소켓은 양산 칩의 수명주기와 관계없이 설계 변경 및 기술 고도화(마이크로그래이션 등)에 따라 반복적으로 수요가 발생한다.

특히, 시스템 반도체의 경우 어드밴스드 패키징 기술이 미세화 및 대형화되는 방향으로 발전하고 있다(아래 왼쪽 그래프 참조). 대면적화 및 I/O(입출력 단자) 수 증가 흐름에 따라 차세대 Chiplet 구조 또는 CoWoS(CoWoS: Chip-on-Wafer-on-Substrate) 기반 테스트 수요가 커지고 있다. 메모리 반도체의 경우에는 미세 피치 기술 확보가 중요해지고, Ball 간격은 0.29mm에서 0.23mm 이하로 좁아지는 추세이다(아래 오른쪽 그래프 참조).

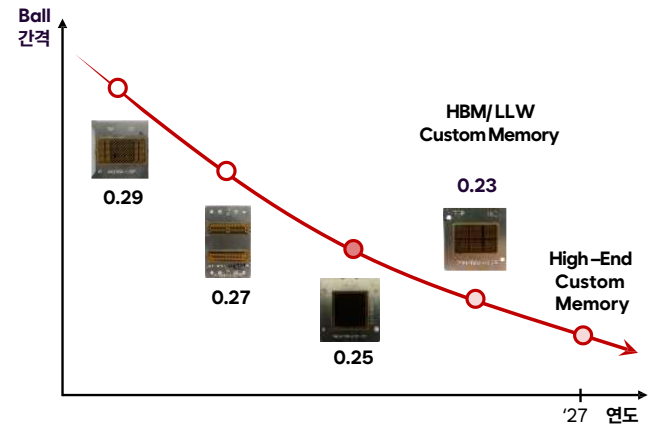
이처럼 메모리와 시스템 반도체 모두 최근 고도로 커스터마이징(맞춤화)된 테스트 소켓이 요구된다. 실제로 리노공업의 경우 전체 매출 내 개발용 테스트 소켓 매출은 약 60~70%를 차지하며, ISC도 비메모리향 소켓 매출 중 R&D 매출 비중이 70% 정도로 추정된다. 결론적으로 테스트 소켓 산업은 반도체 생산량에 기반한 전통적인 소모성 수요 외에도, 기술 변화에 따른 R&D(연구개발) 수요가 비중 있게 발생하는 구조라고 할 수 있다. 특히 AI 가속기 등 복잡하고 대형화된 고성능 칩이 늘어나고 있는 시스템 반도체 분야의 경우 개별 고객사별 설계와 개발 일정에 따른 커스터마이징 테스트 소켓의 필요성이 더욱 확대되고 있으며, 이에 따라 R&D용 테스트 소켓 시장의 성장 속도는 더욱 가속화될 것으로 전망된다.

시스템 반도체는 어드밴스드 패키징 대면적화가 진행 중



자료: ISC, 한국IR협의회 기업리서치센터

메모리 반도체는 미세 피치 기술력 중요해짐



자료: ISC, 한국IR협의회 기업리서치센터



## 투자포인트

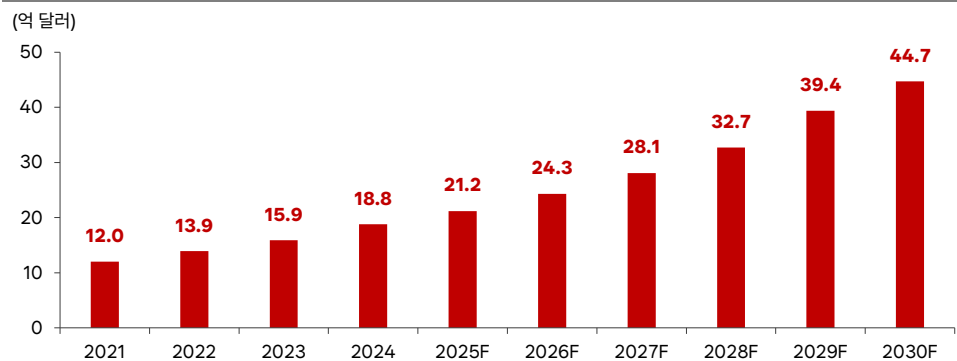
### AI 반도체 시장 성장 수혜 기대

#### AI 반도체 시장 성장에 따른 수혜 전망

AI(인공지능) 반도체 시장 성장의 수혜가 기대된다. 기존에는 특정 일부 GPU 및 HBM 업체들이 초기 AI 반도체 시장을 주도했다면, 2025년 하반기부터는 다양한 ASIC 및 HBM 업체들이 AI 시장 점유율을 늘릴 기회를 잡을 전망이다. 이는 필연적으로 다양한 칩 개발 및 테스트 수요 증가를 야기할 것이다. 특히, 선진국의 빅테크 기업들의 AI 반도체(CPU 등) 연구개발 확대에 견조한 테스트 소켓 수요가 기대된다.

시장조사기관 유레인 리서치에 따르면, 글로벌 AI 가속기 시장은 2021년 12.0억 달러 규모에서 연평균 15.7%로 성장하여 2030년 44.7억 달러 규모에 이를 전망이다. 이러한 시장 성장의 주 요인으로는 1) 생성형 AI 수요 급증, 2) 글로벌 기업들의 자체 AI 칩 개발 가속화, 3) AI 엣지 컴퓨팅 수요 증가, 4) 자율주행 상용화 가속 등을 꼽을 수 있다. 향후 AI 가속기 시장에서는 세부 시장별 특화 및 맞춤형 솔루션 개발 확대, 고효율 AI 가속기 연구개발 트렌드 점증이 예고되고 있다. ISC는 고객별로 맞춤형 테스트 소켓 공급 능력, 장비소재 턴키 공급 능력 등으로 AI 가속기 시장 성장의 과실을 누릴 수 있을 것으로 기대된다.

#### AI 가속기 시장 규모 및 전망



자료: UrainResearch, 한국IR협회의 기업리서치센터

미국 빅테크 기업들을 중심으로 AI 관련 설비투자는 지속적으로 견조할 것으로 기대된다.

#### 메타, 2분기 실적 발표에서 AI 기술의 광고 효율성 기여와 DAU 증가 기여 언급. 3분기 매출 가이드스 및 2025년 설비투자 규모 상향 조정

메타의 최근 실적발표를 주목할 필요가 있다. 메타는 7/30일 미국 현지시간 기준으로 장마감 후 2Q25 실적을 발표하였다. 2분기 매출액, EPS는 각각 47.54B 달러, 7.14달러로 컨센서스(매출액 44.72B 달러, EPS 5.85달러)를 상회하였다. 실적 발표 당시 CEO 마크 주커버그는 AI 기술이 광고 효율성 및 각종 성과 개선에 기여했다고 언급하였다. 메타 앱들의 일일 활성화 이용자수(DAU)는 2분기 기준 34.8억 명으로, 전년 동기 대비 6% 증가한 것이고, 전분기보다 약 5천만 명 순증하였다. 이는 시장의 메타 DAU 기대치 34.5억 명을 상회하는 수치였다.

메타 3분기 분기 매출 가이드스는 47.5B ~ 50.5B 달러로 제시되어 시장 컨센서스 46.3B 달러를 상회하였다. 아울러 중요한 것은 설비투자 관련 언급이었는데, 2025년 설비투자 규모를 66.0B ~ 72.0B 달러로 제시하여 기존 가이드스(64.0B ~ 72.0B 달러) 대비 상향조정하였다. 또한, 2026년 설비투자 규모는 2025년보다 증가할 것이라 강조하였다.

**마이크로소프트는 AI와 클라우드 성장에 따라 4Q25 컨센서스 상회하는 실적 기록. 2026년 매출과 영업이익 두 자릿수 성장을 전망하고 AI 관련 설비투자를 지속적으로 확대할 계획**

마이크로소프트도 7/30 실적발표를 하였다. 4Q25(6월말 결산 기업) 실적은 AI, 클라우드 성장으로 시장 기대를 넘는 서프라이즈를 기록하였다. 4Q25 매출액은 76.4B 달러로 전년 동기 대비 18% 성장했고, EPS는 3.65달러를 기록하여 전년 대비 24% 성장하였다. 매출 중 클라우드 매출액은 46.7B 달러로 전년 대비 27%나 성장하는 모습이었다. AI 인프라 투자 등으로 4Q25 설비투자는 24.2B 달러 규모였으며, 다음 분기에는 30B 달러 이상 설비투자를 계획하고 있다고 언급하였다.

마이크로소프트는 2026년 전년 대비 매출액과 영업이익 두자릿수 성장을 전망하였다. 2026년 설비투자 증가 규모는 2025년 대비는 다소 완만해질 것이라는 기존 전망을 유지하였다. 다만, 현재의 AI 시장 확장 국면에서는 시장 선점과 점유율 확대 여부가 매우 중요하다고 강조하였다. 전반적인 투자 확대로 GP마진 압박은 예상되나, 수익성(영업이익률)을 전년 수준으로 유지할 전망이라고 밝히, 생산성 향상 및 인력감소 추진 등으로 향후 비용 절감에도 나설 것임을 천명하였다.

**빅테크들은 AI 관련 설비투자를 지속 실행할 전망이어서 이는 반도체 테스트 수요에 청신호**

메타, 마이크로소프트의 최근 실적 발표 및 회사 가이드선 등을 종합해보면 알 수 있듯, 빅테크 기업들의 AI 관련 제품과 서비스 사용자는 실제로 확대되고 있으며, 시장 선점을 위하여 빅테크들은 AI 관련 설비투자를 지속적으로 실행할 것으로 전망된다. 이는 반도체 테스트 수요에 있어 청신호로 해석된다.

## **자율주행, 로봇용 소켓 수주 본격화 기대**

**자율주행 및 로봇용 소켓 수요 증가 전망**

자율주행, 로봇용 소켓 수주 본격화도 기대된다.

**글로벌 자율주행 사업의 경우 테슬라와 웨이모 2강 구도 형성 중**

먼저 글로벌 자율주행 산업 현황을 살펴보면, 전세계적으로 테슬라와 웨이모의 2강 구도가 지속되고 있다. 테슬라는 무감독 완전자율주행(Unsupervised FSD)과 로보택시 서비스의 확대를 2025년부터 본격화 중이다. 테슬라는 2026년경 로보택시 전용 모델인 '사이버캡' 출시도 예고하고 있다.

### **테슬라 사이버캡**



자료: Tesla, 한국IR협의회 기업리서치센터

**웨이모는 구글 모회사  
Alphabet의 자회사로,  
세계 최초로 자율주행 로보택시  
상용화를 이룩하고, 글로벌  
자율주행 기술 순위 1위 차지**

웨이모(Waymo, 비상장)는 구글의 모회사인 Alphabet Inc.의 자회사로, 2016년 구글의 자율주행차 부문을 분사하여 설립되었다. Waymo는 2018년 12월 세계 최초로 애리조나주 피닉스에서 자율주행 로보택시를 상용화하고 2020년 11월부터는 안전 요원이 탑승하지 않는 로보택시를 운영했다. 이후 점진적으로 샌프란시스코, 오스틴, LA로 서비스 지역을 확장했다. 2025년 3월에는 샌프란시스코 공항 내 Mapping 작업에 대한 임시 허가를 받았고, 2026년에는 법적으로 운전자가 없는 자율주행 차량 운행을 허용하지 않는 워싱턴DC로의 진출도 계획하고 있다.

웨이모는 글로벌 시장조사업체 가이드하우스 인사이트가 선정한 2024년 글로벌 자율주행 기술 순위 1위, 미국 경제전문 매체 Fast Company가 선정한 2025년 세계 50대 혁신 기업 1위(2023년, 2024년 1위는 각각 OpenAI, Nvidia)로 대외적으로 인정받았다. 이러한 점을 미루어 볼 때, 글로벌 자율주행 선두권 업체로서의 웨이모의 사회적 영향력, 지위 및 평판을 짐작할 수 있다.

**자율주행 기술의 발전에 따라  
ADAS 시장과 차량 내 반도체  
제조 및 테스트 수요 증가 기대**

자율주행의 기술적 미완성에 의한 안정성 여부는 항상 시장 논란 속에 있으나, 자율주행 산업은 꾸준히 발전하고 있다. 시장조사기관 Spherical Insights & Consulting에 따르면, ADAS(첨단 운전자 지원 시스템) 시장 규모는 2022년 312억 달러에서 2032년 757억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이는 예상 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)이 9.2%일 것으로 추정된 것이다.

자율주행 시장 성장에 발맞추어 다양한 비메모리, 메모리 반도체 관련 파운드리 및 패키징 등 반도체 수요가 기대된다. 자율주행 기술이 고도화될수록 차량 내 탑재되는 반도체 개수와 스펙은 점증할 것으로 기대되어, 관련 칩 제조 및 테스트 수요는 견조할 것으로 예상된다. 테슬라의 연도별 칩 개수 및 스펙의 증가세는 이를 시사하고 있다. 테슬라의 버전별 FSD(Full Self Driving) 칩 개수는 2014년 이전에 차량 1대 당 1개 낮은 스펙의 칩(모빌아이 EyeQ3 칩셋)이 탑재되었으나, 2016년 10월경부터 1대 당 2개 칩(Tegra X2 SoC 1개+Pascal GPU 1개) 체제로 변경되었으며, 2019년 3월경부터는 1대 당 2개의 칩을 탑재하되 테슬라가 자체 설계한 고성능 FSD 칩 2개가 탑재되기 시작하였다. 이후 2023년부터는 기존과 같이 칩 개수는 2개이나 FSD Computer 2 시스템 내 최신 FSD 칩 2개가 탑재 중인데, 칩 성능은 이전 세대 칩 대비 3~8배 향상된 것으로 알려져 있다. 결론적으로 자율주행 칩 개수 증가 및 스펙 증가 트렌드는 필연적으로 칩 제조 및 테스트 수요 증가를 야기할 것으로 기대되어 긍정적이다.

**IT 디바이스 내 고성장이 기대되는  
로봇용 소켓 수주 본격화를 예상**

중장기 관점에서 로봇용 소켓 수주 본격화도 기대된다.

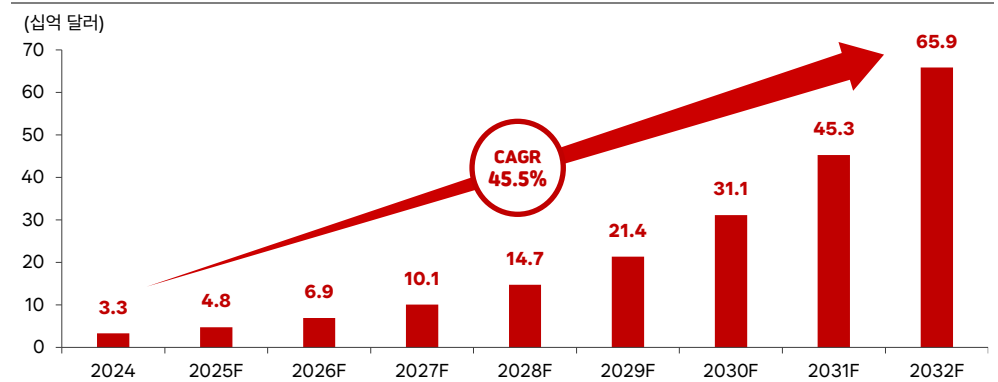
로봇은 IT 디바이스 카테고리 내에서 가장 고성장이 향후 기대되는 디바이스이다. 로봇은 아직은 대중화가 되지 못한 것이 사실이나, 1) 단순 노동에 대한 근로자의 기피 확산, 2) 인건비 상승으로 인한 기업들의 인건비 절감 노력 확대, 3) AI(인공지능)와 결합된 휴머노이드(인간형 로봇) 산업에 대한 기대감 상승 등 트렌드를 볼 때 중장기 성장이 기대된다. 시장조사기관 Markets&Markets에 따르면, 글로벌 협동로봇 시장은 2023년 12억 달러 규모에서 2030년 99억 달러 규모로 연평균 35.1% 성장할 것으로 전망된다. 글로벌 서비스용 로봇 시장도 2023년 281억 달러 규모에서 2030년 776억 달러로 연평균 15.6% 성장할 것으로 예상되고 있다.

**특히 글로벌 휴머노이드 로봇  
시장은 2024년 33억 달러  
규모에서 연평균 45.5%의  
고성장을 전망. ISC는 북미 ASIC  
고객사와 협업 통한 로봇 관련  
테스트 소켓 1H26 생산 예정**

단순한 기계와 협동로봇 레벨을 넘어, 장기적으로 로봇 산업은 휴머노이드(인간형 로봇) 시장 중심으로 고성장할 전망이다. 휴머노이드(인간형 로봇)는 AI와 로봇 결합의 최종 종착지이자, 'Physical AI'를 구현할 수 있는 대표 산업이다. 글로벌 휴머노이드 로봇 시장은 아직 초기 단계이나, Fortune Business Insight에 따르면 2024년 33억 달러 규모에서 연평균 45.5% 성장하며 2032년에는 약 660억 달러 규모에 이를 것으로 전망된다. 이는 기존의 소프트웨어 중심 AI 산업에서 하드웨어 결합을 통한 산업 확장 가능성을 시사하며, 휴머노이드 로봇은 미래 제조 산업의 원가 경쟁력, 생산성, 효율성을 결정짓는 핵심적 역할을 할 것으로 예상된다. 휴머노이드 로봇 산업은 기술적 성숙도와 상업화 측면에서 아직 초기 단계에 있으며, 핵심 기술의 완성도와 생산 단가 문제 해결이 과제로 남아있다. 현재 대부분의 휴머노이드 제품은 프로토타입 단계에 있으며, 기술 혁신과 상용화 진전이 본격적으로 이루어지기에는 다소 시간이 소요될 것으로 예상된다. 그러나 국내/외 수많은 IT기업들이 로봇 기술 관련 차별화된 경쟁력을 확보하려 노력하고 있으며 이는 많은 반도체 칩 및 테스트 수요의 증가를 예고하고 있다.

ISC는 북미 ASIC 고객사와의 협업을 기반으로, 로봇 분야 신규 프로젝트를 물밑에서 진행 중이고, 관련 테스트 소켓 생산은 2026년 상반기경부터 시작할 전망이다.

글로벌 휴머노이드 로봇 시장 규모 및 전망



자료: Fortune Business Insight, 2025.05, 한국IR협회의 기업리서치센터

### 주주가치 친화적인 밸류업 공시는 긍정적

**2027년 ROE 20%,  
총주주환원율 30%,  
ESG 등급 A 달성, 매출 5천억 원  
목표를 제시하는 밸류업 공시 발표**

ISC는 2024.11.29 기업가치 제고 계획(밸류업) 공시를 발표하였다. 발표된 주요 내용은 크게 3가지였다. 이는 1) 밸류업 목표: 2027년 ROE 20%, 총주주환원율 30%, 2027년 ESG 등급 A 달성, 2) 중기성장계획: 2027년 매출액 5천억 원(테스트 소켓 4천억 원, 신성장사업 1천억 원), 3) 소통계획: 핵심지표 투자자 공유, 해외 및 C-레벨 IR 확대, 소통채널 다변화이다.

우선 1번 밸류업 목표를 살펴보면, ISC는 2027년 ROE 20%, 총주주환원율 30% 등을 제시하였다.

동사의 ROE 목표치 20%는 다소 도전적인 것으로 보인다. 동사는 과거 2021년, 2022년에 각각 15%, 18%의 ROE를 달성한 바도 있지만, ROE 수치는 자본총계 대비 순이익률을 의미하므로, 동사가 향후 이익을 꾸준히 낸다면 해마다 자본총계가 커지며 목표 ROE 비율(20%)을 달성하려면 순이익을 매우 양호하게 시현해야 한다. ISC의 2024년 ROE는 11.0% 였고 당사 리서치센터의 2025년 ROE 전망치는 8.5%이다. 따라서 ISC 실적 추세상 2027년 자본총계가 6,000억 원 내외가 될 가능성이 있는 상황에서 ROE 20%를 달성하려면 순이익이 1,200억 원대가 시현되어야 할 것

으로 보인다. 즉, 고부가 제품 매출 확대로 현재보다 수익성을 몇 단계 끌어올린다는 가정을 하지 않는다면 2027년 ROE 20% 목표는 쉽지 않은 달성 과제라고 판단할 수 있다.

총주주환원율은 기업의 순이익 대비 배당금과 자사주 매입/소각 합계 비율로 정의되는데, 당사는 자사주 매입소각에 대한 언급을 하지 않았으므로 총주주환원율이 곧 배당성향인 상황이다. 참고로 2024년 동사 배당성향은 30.3%였다. ISC가 제시한 총주주환원율 30% 목표는 현재 배당성향을 실적의 변동 유무에 관계없이 지속 유지하겠다는 의지 정도로 보인다.

#### ISC 밸류업 목표(~2027년)



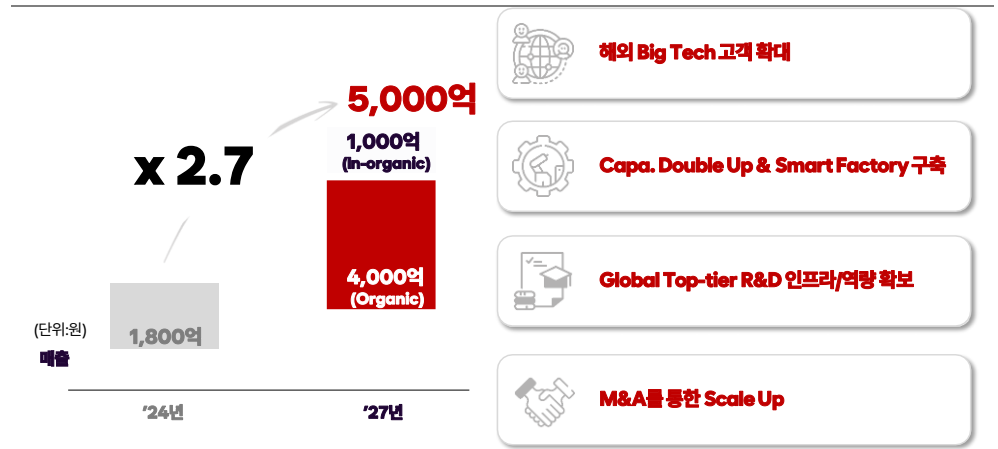
자료: ISC, 한국IR협회의 기업리서치센터

#### 중기성장계획의 경우 소켓 사업의 고성장 달성 여부에 주목할 필요

2번 중기성장계획을 점검해 보면 다음과 같다. 2027년 매출액 5천억 원 목표를 좀더 구체적으로 살펴보면, 테스트 소켓 4천억 원, 신성장사업 1천억 원으로 구분하여 제시하였다. 이의 달성을 위한 전략으로는 1) 해외 빅테크 고객 확대, 2) Capa. 더블 업 + 스마트팩토리 구축, 3) 글로벌 탑티어 R&D 인프라/역량 확보, 4) 인수합병을 통한 스케일 업(Scale Up)을 제시하였다.

종합적으로 볼 때 동 매출 성장 목표는 다소 공격적인 것으로 판단된다. 참고로 당사는 2020년에서 2024년 기간 동안에 매출액이 약 1.4배 성장하였다(2020년 매출액 1,218억 원 VS 2024년 매출액 1,745억 원). 금번 밸류업 공시 목표대로 라면 ISC는 2024~2027년 기간에 매출액이 약 2.8배 뛰어야만 한다. 물론 소켓 사업으로 만은 2024~2027년 기간에 매출액이 약 2.3배만 증가하면 되긴 하나(기존 사업과 별개로 2027년 신성장사업 매출액 1천억 원 규모를 가정하였으므로), 이는 전반적으로 도전적인 측면이 존재하는 것으로 보인다. 투자포인트 챕터에서 다룬 것처럼 AI 반도체 시장 성장 수혜와 자율주행, 로봇용 소켓 수주 본격화 등으로 동사의 성장성은 기대된다. 다만, 전술한 바와 같이 기존 사업인 소켓 사업의 고성장을 가정한 측면이 크므로 투자자는 이의 향후 달성여부를 면밀히 주시해야 한다.

## 중기성장계획



자료: ISC, 한국IR협의회 기업리서치센터

### ISC는 소통계획으로 핵심지표 공유, 해외 IR 확대, C레벨 IR 행사 강화 등을 제시

3번 소통계획을 살펴보면, 동 목표는 정량적 측면보다는 정성적인 측면이 강조될 영역이라 말할 수 있다. ISC는 동 목표에 대해서도 카테고리별 세부 계획을 언급하였다. 즉, 핵심지표 공유에 대해서는 밸류업 주요 사항과 ESG 경영 강화 사항을 공유하겠다고 설명하였고, 해외 IR 확대에 대해서는 외국계 증권사 커버리지 확대와 영문 공시를 언급하였으며, 소통 강화에 대해서는 C레벨 IR 행사 확대와 온/오프라인 소통 채널 다변화를 제시하였다. 이렇듯 카테고리별 세부 계획을 언급한 것은 매우 긍정적으로, 주주 및 잠재주주의 신뢰를 얻는 데에 도움이 될 것으로 판단된다.

## 소통계획



자료: ISC, 한국IR협의회 기업리서치센터

### 결론적으로 밸류업 공시는 주주가치 제고에 긍정적일 것으로 판단되며, 올해 11월말 밸류업 관련 사항 제공시 예정

결론적으로, 2024.11.29에 공시된 ISC의 밸류업 공시는 주주가치 제고에 긍정적일 것으로 판단된다. 동사는 공시를 통해 기업 현황에 대한 진단과 기업가치 제고 관련 목표설정 및 계획 수립을 매우 구체적이고 명확하게 보여주었다고 평가할 수 있다. ISC는 올해 11월말경, 작년 공시한 밸류업 공시에 대한 진행 관련 사항을 재공시할 예정에 있다. 투자자들은 향후 ISC 밸류업 후속 공시를 관심을 갖고 지켜볼 필요가 있다.



## 실적 추이 및 전망

### 2024년 연간 실적 Review

**2024년 연간 매출액, 영업이익은 각각 1,745억 원(+24.4% YoY), 448억 원(+317.1% YoY) 기록**

2024년 연결 기준 연간 매출액은 전년 대비 24.4% 성장한 1,745억 원을 기록했다. 전반적인 반도체 업황 회복이 긍정적이었고 비메모리 분야에서 신규 고객사가 증가한 점이 긍정적으로 작용하였다. 제품별로 구분하여 살펴보면, 동사 주력 제품인 실리콘 소켓이 1,123억 원에서 1,331억 원으로, 포고핀 소켓도 91억 원에서 139억 원으로 견조히 성장하였다. 번인 소켓은 64억 원에서 193억 원으로 대폭 증가했다. 이밖에 장비소재는 17억 원에서 66억 원으로 큰 증가세를 보였다. 반면, 부동산 임대 및 기타는 107억 원에서 17억 원으로 감소하였다. 요약하면 실리콘 소켓과 번인 소켓 제품 성장이 전사 성장을 주도했다고 할 수 있다. 전체 매출액 중 실리콘 소켓 제품 비중은 전년 80.1%에서 2024년 76.3%로 하락하였다. 응용처별로 살펴보면 데이터센터향 및 스마트폰향 매출은 전년 대비 증가하였고, 자동차향 및 LSI(카메라모듈용 이미지센서)향 매출이 감소하였다.

2024년 연결 기준 연간 영업이익은 448억 원으로 전년(107억 원) 대비 크게 성장하였다. 영업이익 개선은 1) 매출 규모 증가로 인한 규모의 경제 효과와, 2) 판관비의 개선에 기인했다. 판관비는 2023년 444억 원에서 2024년 296억 원 수준으로 크게 감소했다. 판관비의 큰 개선은 주식보상비용 급감(151억 원 → 0억 원)이 주효했다.

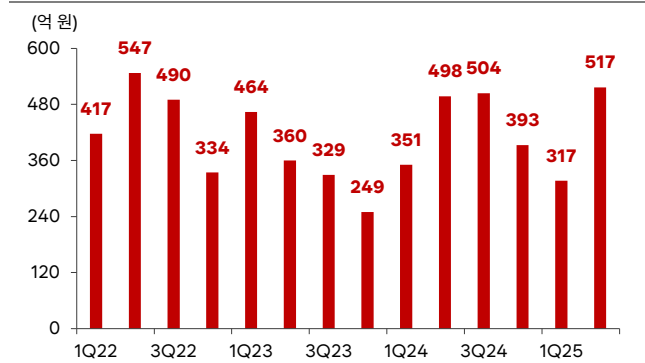
### 1H25 실적 Review

**상반기 매출액, 영업이익 각각 834억 원(-1.8% YoY), 207억 원(-11.8% YoY)을 기록**

2025년 연결 기준 상반기 매출액, 영업이익은 각각 834억 원(-1.8% YoY), 207억 원(-11.8% YoY)을 기록했다. 상반기 매출액은 전년 동기 대비 소폭(1%대) 감소했는데, 이는 1) 제품믹스 상으로 전년 대비 저부가 제품 비중이 다소 증가하였고, 2) 1분기에 특정 고객사 상황이 일시적으로 악화되어 1Q25 주문이 전반적으로 동사 기대에 못 미쳤던 점에 영향을 받았다. 상반기 영업이익 부진은 인건비 등 고정비 증가와 제품믹스 악화가 주요 원인으로 작용했다.

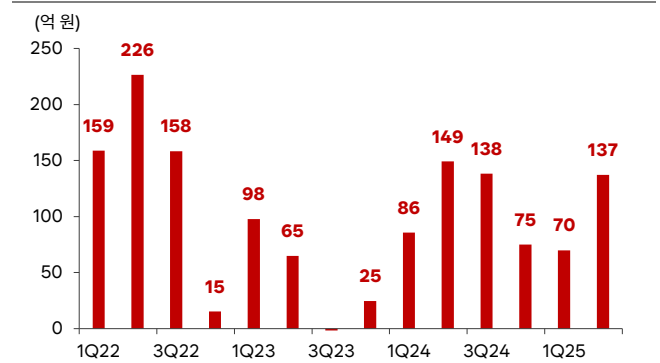
다행히 2분기 들어서며 전분기 대비 AI 반도체(GPU 및 ASIC향 소켓 제품) 매출이 약 104% 증가하는 등 기조적인 회복세가 나타나고 있다. 거기에 인수합병한 아이세미와 테크드림 관련, 6월 한달치가 연결 매출에 반영되기 시작한 점도 긍정적이었다. 1Q25에 ISC는 시장 컨센서스와 상이한 큰 어닝쇼크를 기록했으나, 2Q25에 매출액, 영업이익 각각 517억 원, 137억 원을 시현하며 컨센서스(매출액, 영업이익 각각 534억 원, 영업이익 145억 원)와의 간극을 확실히 줄이는 모습이었다.

분기 매출액 추이(연결 기준)



자료: Quantwise, 한국IR협의회 기업리서치센터

분기 영업이익 추이(연결 기준)



자료: Quantwise, 한국IR협의회 기업리서치센터

### 2025년, 전년에 이어 실적 성장 가능할 전망

**2025년 연간 매출액, 영업이익은  
각각 2,093억 원(+20.0%  
YoY), 502억 원(+12.1%  
YoY)으로 전망**

2025년 동사 연간 실적은 상반기 부진에도 불구하고 의미있는 성장세를 보일 것으로 기대된다. 연간 매출액은 20.0% 성장한 2,093억 원으로 예상한다. 주요 고객인 비메모리 반도체 관련 기업들이 주문을 안정적으로 늘리는 가운데 상반기에 전년 동기 대비 주문이 감소했던 메모리 고객들의 주문 증가가 기대되기 때문이다.

제품별로 보면 여전히 테스트 소켓 위주로 성장할 것으로 기대되고, 인수합병 효과로 인해 장비소재 매출액 증가가 본격화될 전망이다. 2025년 매출액 전망 수치를 살펴보면 다음과 같다. 테스트 소켓 매출액 1,850억 원(+11.3% YoY), 장비소재 매출액 202억 원(+208.4% YoY), 부동산 임대 및 기타 매출액 41억 원(+138.4% YoY)으로 추정된다. 주력 사업인 테스트 소켓 매출이 하반기 들어서며 AI 반도체(GPU 및 ASIC형) 수요 강세 수혜가 더욱 기대되고, 기존에 반영되지 않았던 (인수합병 통한) 장비소재 매출액이 본격적으로 실적에 기여할 것을 고려했다.

2025년 연간 영업이익은 502억 원으로, 전년 대비 12.1% 성장할 것으로 전망한다. 전반적인 매출액 규모 확대로 인해 고정비 부담이 완화되는 점, 데이터센터와 스마트폰용 제품 위주로 믹스 개선 효과가 기대되는 점 등이 실적에 긍정적 영향을 줄 것으로 기대한다. 영업이익률은 전년(25.7%) 대비 1.7%p 하락한 24.0%를 보일 것으로 추정하였다. 이는 여러 긍정적 요인에도 불구하고 1Q25 특정 고객사의 상황이 연중 충분히 만회되지 않을 수 있을 것이라는 보수적 시각을 바탕으로 연간 실적을 추정한 점에 기인한다. 결론적으로 당사 리서치센터는 시장 컨센서스인 연간 매출액 2,117억 원, 영업이익 540억 원 대비는 소폭 보수적인 실적 전망치(매출액, 영업이익 각각 2,093억 원, 502억 원)를 제시하지만 이 역시 건조한 실적이며, ISC 역사상으로는 사상 최대 매출액이 될 것으로 예상된다.

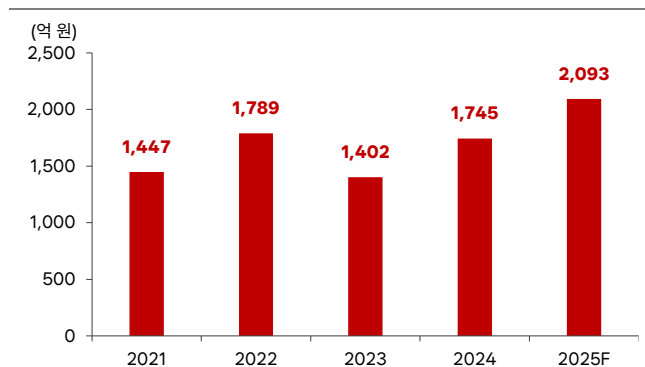
## 실적 추이 및 전망

(단위: 억 원, %)

| 구분                 | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025F        |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| <b>매출액</b>         | 1,447 | 1,789 | 1,402 | 1,745 | <b>2,093</b> |
| <b>Test Socket</b> | 1,267 | 1,668 | 1,279 | 1,662 | <b>1,850</b> |
| 실리콘소켓              | 853   | 1,259 | 1,123 | 1,331 | <b>1,513</b> |
| 포코핀 소켓             | 143   | 240   | 91    | 139   | <b>172</b>   |
| 번인소켓               | 271   | 169   | 64    | 193   | <b>165</b>   |
| <b>장비 소재</b>       | 18    | 15    | 17    | 66    | <b>202</b>   |
| 부품류                | 18    | 15    | 9     | 59    | <b>70</b>    |
| 장비소재               | 0     | 0     | 8     | 7     | <b>132</b>   |
| <b>부동산 임대 및 기타</b> | 162   | 106   | 107   | 17    | <b>41</b>    |
| <b>영업이익</b>        | 375   | 559   | 107   | 448   | <b>502</b>   |
| <b>자배주순이익</b>      | 302   | 440   | 132   | 547   | <b>455</b>   |
| <b>YoY 증감률</b>     |       |       |       |       |              |
| 매출액                | 18.8  | 23.6  | -21.6 | 24.4  | <b>20.0</b>  |
| 영업이익               | 107.5 | 48.9  | -80.8 | 317.1 | <b>12.1</b>  |
| 자배주순이익             | 380.2 | 45.3  | -70.0 | 314.0 | <b>-16.7</b> |
| <b>영업이익률</b>       | 25.9  | 31.2  | 7.7   | 25.7  | <b>24.0</b>  |
| <b>자배주순이익률</b>     | 20.9  | 24.6  | 9.4   | 31.3  | <b>21.8</b>  |

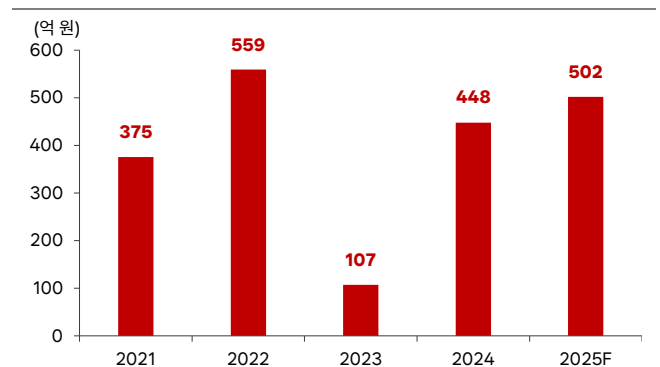
자료: Dart, 한국IR협회의 기업리서치센터

## 매출액 연간 추이 및 전망(연결 기준)



자료: Quantwise, 한국IR협회의 기업리서치센터

## 영업이익 연간 추이 및 전망(연결 기준)



자료: Quantwise, 한국IR협회의 기업리서치센터



## Valuation

### 1 PER 28.0배로 거래 중

동사 PER 밸류에이션은  
코스닥 시장 수준

2025년 8월 11일 기준 ISC 시가총액은 1조 2,739억 원 수준이다. 2025년 동사의 예상 PER은 28.0배 정도로, 코스닥 시장(28.4배)과 유사하게 거래되고 있다.

Peer 기업으로 리노공업,  
티에스이를 선정

ISC는 반도체 테스트 소켓 전문기업이다. 국내에서 동사처럼 반도체 테스트 소켓 사업을 전개하는 상장 기업은 리노공업, 티에스이가 있다. 밸류에이션 관련 Peer 기업으로 리노공업, 티에스이를 선정하여 아래 표와 같이 밸류에이션을 비교해 보았다. 밸류에이션 비교 지표로는 PER을 선택하였다.

2025년 비교 기업들의 밸류에이션은 각각 다음과 같다. 동사 PER 28.0배 VS 리노공업 PER 26.6배, 티에스이 PER 11.3배이다.

리노공업은 국내 반도체 테스트 소켓 분야 1위 기업으로, 동사와 유사한 밸류에이션을 보이고 있다. 리노공업의 2025년 매출액 컨센서스는 전년 대비 약 22% 성장한 3,388억 원으로 기대되고 있다. 리노공업의 수익성은 특히 독보적인데, 2021년부터 매년 40% 이상의 영업이익률을 시현하고 있다. 리노공업은 핵심 부품을 자체 설계·가공하고, 상황 및 디바이스별로 맞춤형 솔루션을 신속히 제공함으로써 외주 대비 공정 단가를 절감하고 있다. 이러한 원가 경쟁력을 기반으로 높은 수익성을 유지(2025F 영업이익률 컨센서스는 45.9%, 2025F ISC의 영업이익률은 24% 추정)하고 있는 모습이다.

티에스이의 경우, 동종그룹 대비 밸류에이션 할인을 받고 있다. 이는 2025년 전년 대비 매출액 성장률이 상대적으로 열위이고(2025년 티에스이 컨센서스 매출액은 3,795억 원으로, 전년 대비 약 9% 성장 전망), 영업이익률도 ISC, 리노공업 대비 현저히 낮을 것으로 전망되기 때문으로 해석된다(티에스이 2025F 영업이익률 컨센서스는 11.5%).

#### 동종 업종 밸류에이션

(단위: 원, 십억 원, 배, %)

| 기업명            | 증가            | 시가<br>총액     | 매출액        |            | PER         |             | PBR        |            |
|----------------|---------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
|                |               |              | 2024       | 2025F      | 2024        | 2025F       | 2024       | 2025F      |
| 코스피            | 3,207         | 2,566,596    | 3,753,881  | 3,020,917  | -           | 11.9        | 1.2        | 1.1        |
| 코스닥            | 812           | 423,399      | 334,267    | 114,230    | -           | 28.4        | 3.2        | 2.7        |
| <b>ISC</b>     | <b>60,100</b> | <b>1,274</b> | <b>174</b> | <b>209</b> | <b>28.0</b> | <b>28.0</b> | <b>2.9</b> | <b>2.3</b> |
| 리노공업           | 46,800        | 3,567        | 278        | 339        | 25.8        | 26.6        | 5.8        | 5.0        |
| 티에스이           | 40,350        | 446          | 348        | 379        | 10.7        | 11.3        | 1.4        | 1.2        |
| <b>동종그룹 평균</b> |               |              |            |            | <b>18.3</b> | <b>19.0</b> | <b>3.6</b> | <b>3.1</b> |

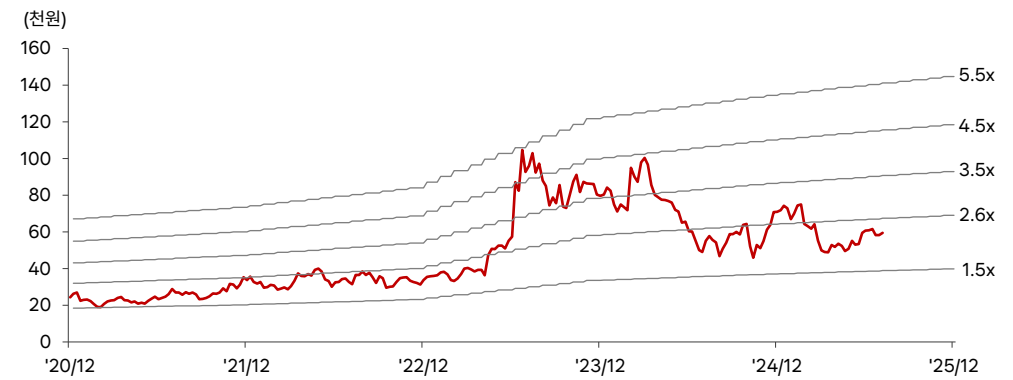
주: 1) 2025년 8월 11일 종가 기준. 동종그룹 25F는 시장 컨센서스 사용

자료: Quantwise, 한국IR협회의 기업리서치센터

ISC의 2024년 연간 주가는 10.2% 하락하였다. 이는 2023년 연간 주가가 156.1% 급등한 이후 숨을 고르는 모습이였다. 참고로 2023년 5월에는 ISC가 SKC(주)에 피인수 되었었고, 2023년 당시 2024년 실적 개선에 대한 기대감이 높아졌던 점도 주가에 긍정적 영향을 주었다고 보인다. 실제로 ISC 연결 영업이익은 2023년 107억 원에서 2024년 448억 원으로 급증하였다.

2025년 연초 대비 ISC 주가는 17.4% 하락한 상태(2024.12.30 주가 72,100원 -> 2025.08.08 주가 59,500원)이다. 이는 상반기 실적이 시장 기대 대비는 소폭 미진했던 것이 주 요인으로 작용한 것으로 해석된다. 오는 하반기 실적이 시장 눈높이를 충족하고, 인수한 아이세미, 테크드림이 ISC 성장에 본격 기여한다면 주가는 그간의 약세를 딛고 반등세를 나타낼 것으로 기대한다.

#### PER Band



자료: Quantwise, 한국IR협회의 기업리서치센터


**리스크 요인**
**1 글로벌 경기의 하락 시 반도체 테스트 소켓 수요 하락 가능성**

글로벌 경기 둔화와  
스태그플레이션 우려 속 미국의  
관세 정책과 경기 지표 악화가  
AI 투자와 반도체 수요에  
부정적 영향을 미칠 가능성 有

글로벌 AI 투자도 경기의 영향을 받을 수 있다. 현재 글로벌 경기 관련, 일부 시장에서는 스태그플레이션 진입 가능성도 제기되고 있다. 스태그플레이션은 '스태그네이션(stagnation)'과 '인플레이션(inflation)'의 합성어로, 스태그플레이션은 경기침체와 물가상승이 동시에 발생하는 경제현상을 의미한다. 일반적으로 경기호황 시 물가상승, 경기침체 시 물가하락이라는 상식을 벗어난 경제 상황을 지칭한다.

미국 트럼프 대통령발 관세 전쟁은 여전히 진행 중이다. 올해부터 재점화된 미국의 공격적인 관세 정책은 글로벌 경기 불확실성을 키우고 있다. 8월 6일 현재 트럼프 대통령은 조만간 반도체와 의약품에 대한 새로운 관세를 부과하겠다는 발언도 하였다. 이로 인한 불확실성은 점증하고 있다. 한편, 8월 5일 발표된 7월 미국 ISM(공급관리협회) 서비스업 지수도 경기 우려를 높이고 있다. 7월 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 50.1로 전월(50.8) 대비 하락하였고, 시장 컨센서스였던 51.5를 크게 밑돌았다. 수치가 기준선인 50에 근접한 만큼 미국 서비스업의 성장이 정체된 것으로 볼 수 있다. 동 수치로 인해 서비스업 관련 향후 수요 둔화와 고용 악화 가능성이 높아진 것이 아니냐고 우려할 수 있다.

경기가 둔화될 시 기업들의 설비투자는 전반적으로 위축될 가능성이 있고, 상대적으로 견조하고 기초적인 AI 관련 투자조차도 일부 흔들릴 수 있다고 판단된다. 글로벌 경기의 급락이 현실화될 시 반도체 전반의 수요 하락에 따른 반도체 테스트 소켓 수요 하락 가능성도 있다. 이는 ISC에게만 국한된 리스크는 아니나, 반도체 업계 전체에 우려감을 줄 수 있는 요인이라 보인다.

포괄손익계산서

| (억원)          | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025F |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 매출액           | 1,447 | 1,789 | 1,402 | 1,745 | 2,093 |
| 증가율(%)        | 18.8  | 23.6  | -21.6 | 24.4  | 20.0  |
| 매출원가          | 819   | 945   | 851   | 1,001 | 1,221 |
| 매출원가율(%)      | 56.6  | 52.8  | 60.7  | 57.4  | 58.3  |
| 매출총이익         | 628   | 844   | 552   | 744   | 872   |
| 매출이익률(%)      | 43.4  | 47.2  | 39.3  | 42.6  | 41.7  |
| 판매관리비         | 253   | 285   | 444   | 296   | 370   |
| 판매비율(%)       | 17.5  | 15.9  | 31.7  | 17.0  | 17.7  |
| EBITDA        | 474   | 696   | 194   | 546   | 597   |
| EBITDA 이익률(%) | 32.8  | 38.9  | 13.9  | 31.3  | 28.5  |
| 증가율(%)        | 76.1  | 46.9  | -72.1 | 181.2 | 9.3   |
| 영업이익          | 375   | 559   | 107   | 448   | 502   |
| 영업이익률(%)      | 25.9  | 31.2  | 7.7   | 25.7  | 24.0  |
| 증가율(%)        | 107.5 | 48.9  | -80.8 | 317.1 | 12.1  |
| 영업외손익         | -0    | 63    | 68    | 248   | 78    |
| 금융수익          | 7     | 10    | 119   | 262   | 110   |
| 금융비용          | 7     | 1     | 66    | 74    | 77    |
| 기타영업외손익       | 0     | 53    | 16    | 60    | 45    |
| 총속/관계기업관련손익   | -1    | -0    | 0     | 0     | 0     |
| 세전계속사업이익      | 374   | 621   | 176   | 696   | 580   |
| 증가율(%)        | 269.2 | 66.2  | -71.7 | 296.2 | -16.6 |
| 법인세비용         | 73    | 182   | 40    | 147   | 120   |
| 계속사업이익        | 301   | 439   | 136   | 549   | 460   |
| 중단사업이익        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 당기순이익         | 301   | 439   | 136   | 549   | 460   |
| 당기순이익률(%)     | 20.8  | 24.6  | 9.7   | 31.5  | 22.0  |
| 증가율(%)        | 446.5 | 46.0  | -69.1 | 304.2 | -16.2 |
| 지배주주지분 순이익    | 302   | 440   | 132   | 547   | 455   |

현금흐름표

| (억원)            | 2021 | 2022 | 2023  | 2024   | 2025F |
|-----------------|------|------|-------|--------|-------|
| 영업활동으로인한현금흐름    | 393  | 654  | 224   | 507    | 450   |
| 당기순이익           | 301  | 439  | 136   | 549    | 460   |
| 유형자산 상각비        | 86   | 122  | 71    | 86     | 88    |
| 무형자산 상각비        | 12   | 15   | 16    | 12     | 8     |
| 외환손익            | 1    | 43   | 14    | 15     | 0     |
| 운전자본의감소(증가)     | -81  | -67  | 1     | -107   | -39   |
| 기타              | 74   | 102  | -14   | -48    | -67   |
| 투자활동으로인한현금흐름    | -40  | -759 | -16   | -2,519 | -332  |
| 투자자산의 감소(증가)    | 36   | -250 | 97    | 201    | -1    |
| 유형자산의 감소        | 11   | 1    | 13    | 62     | 0     |
| 유형자산의 증가(CAPEX) | -142 | -195 | -145  | -114   | 0     |
| 기타              | 55   | -315 | 19    | -2,668 | -331  |
| 재무활동으로인한현금흐름    | -215 | 144  | 1,937 | -270   | -164  |
| 차입금의 증가(감소)     | -11  | -59  | 44    | -230   | 1     |
| 사채의증가(감소)       | -45  | 243  | 0     | 0      | 0     |
| 자본의 증가          | 0    | 0    | 1,998 | 0      | 0     |
| 배당금             | -21  | -32  | -100  | -41    | -166  |
| 기타              | -138 | -8   | -5    | 1      | 1     |
| 기타현금흐름          | 3    | -14  | -2    | 1      | 62    |
| 현금의증가(감소)       | 140  | 26   | 2,143 | -2,281 | 16    |
| 기초현금            | 371  | 511  | 537   | 2,680  | 399   |
| 기말현금            | 511  | 537  | 2,680 | 399    | 414   |

재무상태표

| (억원)      | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025F |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 유동자산      | 983   | 1,617 | 3,618 | 4,051 | 4,519 |
| 현금성자산     | 511   | 537   | 2,680 | 399   | 414   |
| 단기투자자산    | 35    | 536   | 526   | 3,070 | 3,406 |
| 매출채권      | 228   | 209   | 210   | 329   | 395   |
| 재고자산      | 145   | 225   | 154   | 154   | 185   |
| 기타유동자산    | 63    | 109   | 48    | 99    | 119   |
| 비유동자산     | 1,634 | 1,967 | 1,800 | 1,778 | 1,683 |
| 유형자산      | 1,113 | 1,339 | 928   | 922   | 834   |
| 무형자산      | 92    | 232   | 214   | 177   | 169   |
| 투자자산      | 162   | 138   | 99    | 86    | 87    |
| 기타비유동자산   | 267   | 258   | 559   | 593   | 593   |
| 자산총계      | 2,617 | 3,584 | 5,418 | 5,829 | 6,202 |
| 유동부채      | 348   | 814   | 583   | 523   | 587   |
| 단기차입금     | 100   | 130   | 178   | 0     | 0     |
| 매입채무      | 12    | 82    | 48    | 76    | 91    |
| 기타유동부채    | 236   | 602   | 357   | 447   | 496   |
| 비유동부채     | 43    | 90    | 101   | 75    | 89    |
| 사채        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 장기차입금     | 5     | 52    | 32    | 1     | 1     |
| 기타비유동부채   | 38    | 38    | 69    | 74    | 88    |
| 부채총계      | 391   | 904   | 684   | 597   | 676   |
| 지배주주지분    | 2,227 | 2,681 | 4,733 | 5,228 | 5,518 |
| 자본금       | 83    | 87    | 106   | 106   | 106   |
| 자본잉여금     | 1,114 | 1,178 | 3,157 | 3,157 | 3,157 |
| 자본조정 등    | -268  | -270  | -270  | -271  | -271  |
| 기타포괄이익누계액 | -8    | -23   | 7     | 15    | 15    |
| 이익잉여금     | 1,306 | 1,709 | 1,733 | 2,220 | 2,510 |
| 자본총계      | 2,226 | 2,680 | 4,735 | 5,231 | 5,526 |

주요투자지표

|              | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025F  |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| P/E(배)       | 19.0   | 12.4   | 111.5  | 28.0   | 28.0   |
| P/B(배)       | 2.6    | 2.0    | 3.6    | 2.9    | 2.3    |
| P/S(배)       | 4.0    | 3.0    | 10.5   | 8.8    | 6.1    |
| EV/EBITDA(배) | 11.5   | 6.9    | 73.3   | 22.0   | 15.3   |
| 배당수익률(%)     | 0.6    | 1.9    | 0.2    | 1.1    | 1.3    |
| EPS(원)       | 1,857  | 2,532  | 720    | 2,579  | 2,148  |
| BPS(원)       | 13,459 | 15,408 | 22,330 | 24,663 | 26,030 |
| SPS(원)       | 8,880  | 10,304 | 7,652  | 8,231  | 9,874  |
| DPS(원)       | 200    | 600    | 200    | 810    | 810    |
| 수익성(%)       |        |        |        |        |        |
| ROE          | 15.3   | 17.9   | 3.6    | 11.0   | 8.5    |
| ROA          | 12.0   | 14.2   | 3.0    | 9.8    | 7.6    |
| ROIC         | 21.8   | 26.2   | 5.9    | 25.1   | 30.0   |
| 안정성(%)       |        |        |        |        |        |
| 유동비율         | 282.2  | 198.7  | 621.1  | 775.0  | 769.6  |
| 부채비율         | 17.6   | 33.7   | 14.4   | 11.4   | 12.2   |
| 순차입금비율       | -17.3  | -25.5  | -58.5  | -62.3  | -65.3  |
| 이자보상배율       | 91.7   | 578.4  | 5.0    | 28.2   | 48.5   |
| 활동성(%)       |        |        |        |        |        |
| 총자산회전율       | 0.6    | 0.6    | 0.3    | 0.3    | 0.3    |
| 매출채권회전율      | 6.6    | 8.2    | 6.7    | 6.5    | 5.8    |
| 재고자산회전율      | 10.9   | 9.7    | 7.4    | 11.3   | 12.3   |

최근 3개월간 한국거래소 시장경보제도 지정 여부

시장경보제도란?

한국거래소 시장감시위원회는 투기적이거나 불공정거래 개연성이 있는 종목 또는 주가가 비정상적으로 급등한 종목에 대해 투자자주의 환기 등을 통해 불공정거래를 사전에 예방하기 위한 제도를 시행하고 있습니다. 시장경보제도는 '투자주의종목 투자경고종목 투자위험종목'의 단계를 거쳐 이루어지게 됩니다.  
※관련근거: 시장감시규정 제5조의2, 제5조의3 및 시장감시규정 시행세칙 제3조~제3조의 7

| 종목명 | 투자주의종목 | 투자경고종목 | 투자위험종목 |
|-----|--------|--------|--------|
| ISC | X      | X      | X      |

발간 History

| 발간일        | 제목                       |
|------------|--------------------------|
| 2025.08.13 | ISC-성장이 기대되는 테스트 소켓 전문기업 |

Compliance notice

본 보고서는 한국거래소, 한국예탁결제원과 한국증권금융이 공동으로 출연한 한국IR협의회 산하 독립 (리서치) 조직인 기업리서치센터가 작성한 기업분석 보고서입니다. 본 자료는 투자자들에게 국내 상장기업에 대한 양질의 투자정보 제공 및 건전한 투자문화 정착을 위해 무상으로 작성되었습니다.

- 당사 리서치센터는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트와 그 배우자 등 관계자는 자료 작성일 현재 조사분석 대상법인의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 본 자료는 중소형 기업 소개를 위해 작성되었으며, 매수 및 매도 추천 의견은 포함하고 있지 않습니다.
- 본 자료에 게재된 내용은 애널리스트의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.
- 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 자료제공일 현재 시점의 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다.
- 본 조사자료는 투자 참고 자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 투자자의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증명자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사자료의 지적재산권은 당사에 있으므로, 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.
- 본 자료는 텔레그램에서 "한국IR협의회(<https://t.me/kirsofficial>)" 채널을 추가하시어 보고서 발간 소식을 안내받으실 수 있습니다.
- 한국IR협의회가 운영하는 유튜브 채널 'IRTV'에서 1) 애널리스트가 직접 취재한 기업탐방으로 CEO인터뷰 등이 있는 '小中한탐방'과 2) 기업보고서 심층해설방송인 '小中한 리포트 가치보기'를 보실 수 있습니다.